公司代码:688002　　公司简称:睿创微纳

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。因此,公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至 2026 年 4 月 8 日,公司总股本 465,736,088 股,扣减回购专用证券账户中股份总数 8,263,600 股后的股本 457,472,488 股为基数,以此计算合计拟派发现金红利 137,241,746.40 元(含税),占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 12.20 %。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算”,公司 2025 年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为 35,262,777.31 元(不含印花税、交易佣金等交易费用),占归属于上市公司股东净利润的 3.14%。

2025 年半年度公司现金分红 36,157,929.36 元,占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 3.22%。

综上,2025 年度公司现金分红总额 208,662,453.07 元(含税),占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 18.56%。

本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配总额不变,相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	睿创微纳	688002	不适用	

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄艳	杨雪梅
联系地址	中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号	中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号
电话	0535-3410615	0535-3410615
传真	0535-3410610	0535-3410610
电子信箱	raytron@raytrontek.com	raytron@raytrontek.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司是领先的、专业从事专用集成电路、特种芯片设计与制造技术开发的国家高新技术企业,深耕红外、微波、激光等多维感知领域,掌握多光谱传感研发的核心技术与 AI 算法研发等能力,为全球客户提供性能卓越的 MEMS 芯片、ASIC 处理器芯片、红外热成像全产业链产品和激光、微波产品及光电系统,广泛应用于夜视观察、人工智能、卫星通信、自动驾驶、无人机载荷、机器视觉、智慧工业、公安消防、物联网、智能机器人、激光测距等领域。

2.2 主要经营模式

(1)采购模式

公司主要采购的原材料或服务包括晶圆、管壳、电子元器件、结构件、镜头、PCB&PCBA、显示模组、显示屏等。

公司由采购中心负责公司研发、生产所用以上物资的采购业务。

公司产品所涉及的技术工艺较为复杂,同时客户对产品质量及交付及时性要求较高,因此,对于关键物料公司采取签订年度合同、分批交付模式,以较低成本保证正常生产需要及合理控制库存。

公司通过严格筛选比对确定关键物料供应商,并形成了长期稳定的合作关系;与核心物料供应商建立了战略合作关系,确保物料质量及交付及时性满足客户要求。

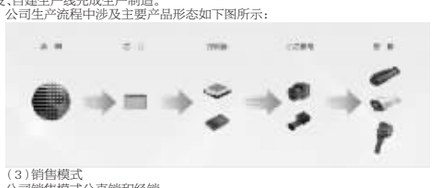
(2)生产模式

公司生产模式与产品特性相关,主要采取以销定产方式,同时辅以市场预测信息安排生产。

公司加强供应链管理工作,逐步实现生产管理的标准化、自动化、信息化,细化管理颗粒度。针对标准的红外探测器及热成像机芯模组产品进行年度和半年度滚动预测,做好原材料和成品安全库存储备,同时加大长周期、通用电子物料备货以应对供应等不利影响,极大缩短产品交期,在有效控制物料库存的情况下,确保业务快速上升阶段订单准时交付。

公司具备 CMOS 读出电路、MEMS 红外传感器晶圆、红外探测器、热成像机芯模组及红外热像仪整机产品的全自主开发能力。其中 CMOS 读出电路晶圆委托晶圆代工厂依据公司提供的读出电路设计版图为公司定制生产;MEMS 晶圆由代工厂根据公司的设计以及工艺流程进行晶圆加工(此 MEMS 晶圆生产线由公司与代工厂共建);红外探测器、热成像机芯模组及红外热像仪整机产品均是公司自主研发、自建生产线完成生产制造。

公司生产流程中涉及主要产品形态如下图所示:



(3)销售模式

公司销售模式分直销和经销。

在 B2B 端,公司销售模式以直销为主。公司对外销售的产品主要包括红外探测器、热成像机芯模组、红外热像仪整机以及 T/R 组件、激光测距模块等产品,主要客户为特种装备整机或系统厂商、民用安消防、无人机、工业智能控制、红外测温产品集成商等,部分客户可能存在定制化需求,且需要红外热成像系统运行的技术支持,对批量交付能力、产品质量、服务保障均有较高要求。

在直销模式中,公司通过公开招投标或客户对产品择优比选等方式实现产品销售。在对产品择优比选中,客户一般会综合考虑产品性能、质量、技术能力、批量交付能力、价格及服务保障等因素确定供应商供货资格。公司通过专业的销售和技术团队,针对客户需求提出最佳方案。在特种装备销售中,公司配合整机和系统厂商参加特种装备型号的竞标,中标后配合装备需求方进行产品试验及定型,最终根据装备需求方订单供货。

在 B2C 端,公司销售模式以经销模式为主,辅以电商销售。销售的主要产品为户外热成像夜视仪、手机热像仪、手持热成像测温仪等产品。公司根据经销商的商誉、渠道资源、专业能力,通过择优选取确定国内外经销商。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司已形成红外业务为主,微波、激光等多维感知领域逐步突破的新格局,有力支撑了公司持续快速发展。目前公司产品主要面向特种装备及民用两大市场。

(1)红外热成像技术最早运用在防务领域,在特种装备上有极高的应用价值,其最重要的应用是夜间观察和目标探测。红外热像仪是利用红外热成像技术将被测目标的红外辐射能量转变为红外热像图。自上世纪 70 年代起,欧美一些发达国家先后开始使用红外热像仪在各个领域进行探索。随着红外热成像技术的发展与成熟,各种适用于民用的低成本红外热成像设备出现,其在国民经济各个领域发挥着越来越重要的作用。

在防务领域,红外热像仪以被动的方式探测物体发出的红外辐射,比其他带光源的主动成像系统更具有隐蔽性。鉴于其隐蔽性好、抗干扰性强、目标识别能力强、全天候工作等特点,红外热像仪被广泛应用于侦察、监视和制导等特种装备上,主要用途包括坦克、装甲车等特种车辆的夜视,单兵夜视装备、飞机和导弹武器,特种舰艇夜间识别和射击指挥系统等。特种装备类红外产品从上世纪 70-80 年代起就逐步应用于海陆空战场,经过数十年的技术迭代及产品换代,目前红外产品在美国、法国等发达国家防务领域的普及率较高。根据 Yole《thermal imaging and sensing 2025》报告数据,防务与航空航天领域的热像仪市场规模预计将从 2024 年的 27.8 亿美元增长至 2030 年的 38.51 亿美元,年复合增长率达 5.5%。同时,西方发达国家对于红外热成像采取严格的技术封锁及产品禁运政策,也制约了全球防务市场规模的大幅增长。目前国际特种装备类红外热像仪主要被欧美发达国家企业主导占据,因各国保持高度敏感性、限制或禁止向国外出口,大部分市场集中在欧美地区,而亚太地区的产业生态近年来发展迅速,本土供应链能力持续增强,在全球出货量中占据重要份额。与国际市场相比,我国防务红外市场虽起步相对较晚,但目前正处于应用快速普及与技术持续升级并行的关键发展阶段。我国红外热成像技术在单兵、防务无人机、坦克装甲车辆、舰船、无机和红外制导武器在内的红外装备市场的应用广度与深度不断提升,市场需求旺盛。国内特种装备类与防务无人机类红外热像仪市场属于朝阳行业,行业渗透率较低,未来发展空间广阔。

在民用领域,随着技术的发展以及产品成本和价格的降低,红外热成像的应用场景更加广泛,涵盖安防监控、个人消费、辅助驾驶、消防及警用、工业监测、人体体温筛查、电力监测、医疗检疫等诸多领域。红外热像仪行业已充分实现市场化竞争,各企业间向市场自由竞争。红外热像仪在民用市场的快速增长主要来源于产品成本下降带来新应用领域的不断扩大,随着红外热像仪在电力、消费、建筑、执法、消防、车载等行业应用的推广,民用红外热像仪行业将迎来市场需求的快速增长期。根据 Yole《thermal imaging and sensing 2025》中的数据,全球热像仪市场规模预计将从 2024 年的 72 亿美元增长至 2030 年的 92.6 亿美元,期间复合年增长率(CAGR)约为 4.2%。随着我国经济持续发展,国内红外热成像产品价格的逐步降低及应用的普及,市场对于红外热像仪的需求也日趋旺盛。由于红外热像仪产品应用领域广泛,且能为人们生产生活提供极大的便利性,未来对红外热像仪的市场需求将会保持持续稳定的增长态势。除了传统应用行业外,未来将有更多新兴市场需求成为红外成像市场新的增长极。

随着近年的发展,我国红外热成像行业的研究开发能力有了长足的进步。红外热像仪的研制与开发涉及到光学、电子、计算机、物理学、图像处理、新材料、机械等多个学科,研制的难度较高,因此仍旧面临着技术壁垒、人才壁垒、资质壁垒等瓶颈。

1、技术壁垒

红外热像仪(包括芯片探测器)的研发、生产过程中需要运用到基础物理、材料、光学、热学、机械、微电子、计算机、软件、图像处理等多个学科领域的知识,技术含量高;另外,红外热像仪的生产过程包括流片、封装、测试、标定、检验等,需要拥有专业化、高投入的工艺技术平台;再加上红外热成像技术仍属于应用拓展阶段,新的应用市场不断涌现,产品研发要有较为雄厚的技术储备作为基础,以尽量缩短研发周期,快速推出适应新市场需求的新型产品,从而占领新的市场。这对红外热像仪厂商的技术积累提出了较高要求,而对于本行业的新进入者也形成了较高的技术门槛。

2、人才壁垒

红外热像仪(包括芯片探测器)研发、生产的技术综合性要求厂商需要有多领域的人才储备,例如专门的集成电路设计人员、MEMS 传感器设计人员、封装测试人员、红外光学系统设计人员、软件设计人员、信息处理电路设计人员、整机系统设计人员等。国内相关技术的研发人员总体数量偏少,行业新进入者同时获得相关各个领域的人才具有相当难度。另外将其聚集、磨合、形成团队力量并开发出新产品也要经过多年的实践。同时,一些关键工艺岗位也需要经验丰富的技术工人才能胜任。因此,本行业对新进入者具有较高的人才壁垒。

3、资质壁垒

民用领域的部分行业对于红外热像产品的生产销售也要求通过相应的资质认证,如专业从事医疗检疫用的医用红外热像仪生产厂商需要获得《医疗器械生产企业许可证》等。

根据国务院、中央军委发布的《武器装备科研生产许可管理条例》,提供特种装备类红外热像产品的厂商首先需通过相应的保密资格认证、质量管理体系认证、武器装备质量管理体系认证等相关认证并取得相应资格或证书;另外还需具有装备承制单位资格认证、武器装备科研生产许可等资质。

上述资质要求对行业新进入者构成较高的进入门槛。

(2)微波行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据电磁波频段不同,通常将 0.1GHz-6GHz 电磁波称为“射频”,将 6GHz-30GHz 电磁波称为“微波”,将 30GHz-100GHz 电磁波称为“毫米波”,将 100GHz 以上电磁波称为“太赫兹”。更加常见和通俗的做法是将射频、微波、毫米波、太赫兹统称为“微波”或“射频”。

微波行业所涵盖的内容非常广泛,其基本原理是:利用电磁波的物理特性,实现通信、感知、能量传递等应用目的。例如,手机、基站、卫星导航与通信等应用利用不同频段的电磁波实现无线通信;机载、舰载、车载雷达以及民用车载毫米波雷达等应用,利用不同频段的电磁波实现探测与感知;微波炉、射频等离子增强等应用,利用特定频段电磁波实现微波加热与能量传递。微波在防务及民用各领域具有非常广泛的应用,已经深入到人们日常工作生活的方方面面。

在通信、感知、能量传递三大典型微波应用领域中,相比于能量传递,通信与感知的应用场景更为广泛、市场规模也更大。微波通信与感知应用的具体产品形态,从底层到顶层又可以细分为微波半导体(材料、器件、工艺、电路、封装)、射频模块与组件、天线与子系统、整机等,细分领域较为繁杂。在微波通信与感知的大领域,其生态链、供应链、产业链是形态复杂而且规模庞大的;通常单个企业都是在某个细分环节或细分领域上布局,曾如专注于微波半导体或专注于微波电子整机,极少有企业的营业范围囊括全部链条环节。

微波行业的市场规模较大,根据 Yole 公司的市场调查与预测数据,目前全球消费类射频前端集成电路每年市场规模超过 200 亿美元,且未来多年将保持超过 10%的年均复合增长率;全球基站端射频前端集成电路每年市场规模超过 30 亿美元,且未来多年将保持超过 5%的年均复合增长率。在防务装备领域,稳步增长的国防预算为国内市场增长提供支撑,国防信息化战略有力推动相控阵雷达发展,有源相控阵雷达凭借其独特的优势,已广泛应用于飞机、舰船、卫星等装备上,成为目前雷达技术发展的主流趋势。此外,低轨卫星通信网络在全球通信和互联网接入、5G、物联网等应用领域极具潜力,全球卫星争夺战拉开序幕,卫星市场进入快速成长期。微波半导体及微波组件、相控阵天线、雷达整机需求景气,市场空间广阔。因此,微波领域的大部分细分领域都有较大的市场容量,其中的市场机会和潜力引人入胜。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

红外领域,目前国际上仅美国、法国、以色列、中国等少数国家掌握非制冷红外芯片设计技术,国外主要供应商对我国存在一定的出口限制,公司经过自身发展填补了我国在该领域高精度芯片研发、生产、封装、应用等方面的一系列空白,成为国内为数不多的具备红外探测器芯片自主研发能力并实现量产的公司之一。

公司是研发驱动型企业,在非制冷红外热成像领域具备完善的技术和产品研究、开发和创新体系,具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力。公司已掌握集成电路设计、MEMS 传感器设计及制造、封装测试、机芯图像算法开发、系统集成等非制冷红外成像全产业链核心技术及生产工艺。公司成功研发出世界第一款像元间距 8μm、面阵规模 1920×1080 的大面阵非制冷红外探测器,第一款 6μm 640×512 非制冷红外探测器,提出行业第一个红外真彩转换算法并建立了第一个红外开源平台,夯实了公司在非制冷红外领域国内领先,国际先进的技术地位。

国内非制冷红外行业经过多年的发展和技术积累,最近几年具备了红外探测器的自主研发及制造能力。随着进口替代进程的逐步推进,以及国内红外市场空间的迅速扩大,未来将有更多资源和人才进入本行业。在行业快速发展的背景下,依靠前期的技术积累、人才储备和品牌效应等先发优势的头部企业,不断扩大市场份额,行业集中度将会进一步提高。

微波领域,微波半导体方面的国际领先企业包括:Skyworks,Oorvo,Oualcomm,Analog Device,NXP,Infineon,ST,MuRata 等,国内的参与者包括卓胜微、唯捷创芯、国博电子、锐昌科技等优秀企业。整机方面,民用领域的巨头包括各大手机与基站制造商,防务领域则包括欧美和我国的各大军工企业,如洛克希德-马丁、诺斯罗普-格鲁门、雷神、中国电子科技集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团等。

公司在微波领域已建立完整产业链,以 T/R 组件、相控阵子系统及雷达整机切入微波领域,同时在底层的微波半导体方面持续建设核心竞争力。基于上述思路,公司于 2018 年在成都市局相控阵天线子系统及地面监视雷达整机等微波业务;于 2021 年和 2024 年先后收购无锡华测合计 71.87%的股权,布局 T/R 组件业务。上述两步为公司在微波领域的业务打开了发展通道,获得了宝贵的资质,凝聚了技术团队,并为微波半导体业务的展开和发展构筑了牵引力和推动力。报告期内,模块、组件、整机业务继续稳步推进,研发和市场开拓均取得了显著进展;同时,公司着重建设微波半导体团队和业务能力,重点打造化合物半导体单片微波芯片和硅基毫米波芯片核心技术和拳头产品。

截至报告期末,公司拥有研发人员 1860 人,占公司总人数的 51.85%。公司累计申请知识产权 3824 个,已获批 2391 个。公司于 2020 年获批作为牵头单位承担“电子元器件领域工程研制”国家科技重大专项研发任务,课题类型为非制冷红外科研领域高灵敏度技术方向;于 2022 年中标发改委某射频芯片项目,助力国家卫星通信产业发展。

报告期内,公司基于业内领先的技术水平、可靠的产品性能及稳定的量产能力,实现销售收入稳步增长。未来,公司将持续进行研发投入,进一步巩固核心竞争力,力争市场地位稳中求进。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)红外技术创新向小像元间距、晶圆级封装、ASIC 集成及 AI 赋能等方向发展

随着非制冷热成像产品在安防、测温、汽车和个人视觉系统中的广泛应用,市场对热成像模组的分辨率、功耗、体积和价格提出了新的要求,更大面阵规模、更小像元间距、更小封装体积、更高集成化日益成为主流发展方向。

当前,业内非制冷红外芯片像元尺寸已从 35μm 迭代至主流 12μm,并向 8μm 及以下更小尺寸快速演进,进一步推动芯片小型化、低成本化,适配更广泛民用场景。小像元尺寸的优势在于,更小像元尺寸是缩小芯片尺寸,降低芯片成本,进一步满足热成像模组小型化、集成化需求的基础。另外,相同焦距光学系统下,像元尺寸越小,空间分辨率越高,并且对于同一物体,像元尺寸越小辨识距离越远。因此,小像元尺寸是技术创新的主流方向。

当前,业内红外探测器已从金属封装、陶瓷封装技术过渡到晶圆级封装。随着晶圆级封装、3D 封装的逐步成熟,业内企业已实现先整体封装后进行切割的封装工艺,新的封装工艺能够大大提高规模效应和生产效率,有效降低封装成本。此外,晶圆级封装能够大幅度减小探测器的封装体积,满足热成像模组小型化、轻量化的需求。因此,基于晶圆级封装的先进技术创新成为主流发展方向。

红外成像产品的信号和图像处理电子器件领域,ASIC 芯片集成方式正日益普及,并在中高端及规模化应用中加速替代传统的 FPGA 方案。近年来,行业内采用 ASIC 芯片集成方式替代传统成像模组的 FPGA 方式,显著减小了成像模组尺寸,降低了成像模组功耗,降低了量产成本,从而更好地满足消费电子、汽车辅助驾驶等新兴市场对小型化、低功耗与低成本的核心需求。未来,随着采用 ASIC 集成方式的产品量产,规模化效应凸显,更多的业内厂商将会采用此种技术,ASIC 芯片集成已成为红外成像技术发展的明确主流趋势,未来,与 AI 加速器融合的 SoC 方案将进一步强化其在终端智能分析方面的优势。

当前,人工智能(AI)技术与热成像的深度融合正成为重要趋势。AI 算法广泛应用于图像增强、智能诊断、目标识别与分类等,显著提升了热成像系统的自动化和智能化水平,不断解锁如自动驾驶、工业预测性维护、智慧安防等新应用场景。未来的技术创新将更侧重于通过软硬件协同优化,提升系统级性能并降低总成本。

(2)高度集成化、模块化成为微波半导体发展趋势

随着通信标准的演进,5G 技术的运用使得单个宏基站的覆盖范围变小、信号穿透力变弱,因此,微基站的大规模应用成为必然趋势。受体积和载体限制,微基站对集成电路集成化程度的要求也更高。有源相控阵体制具有抗干扰能力强、高可靠、多模式等领先优势,这使得基于有源相控阵体制的无线电子信息系统逐步成为了当前及未来先进无线系统的主流发展方向,相关技术体系不断趋于成熟化,广泛应用于精确制导、雷达探测与移动通信领域,T/R 组件作为其必需的核心部件将直接影响相控阵系统的综合性能。随着有源相控阵技术在各类无线通信、探测感知等先进技术的发展,无线电子信息系统的功能越发复杂,单位载荷的功能密度需求大幅提高,多功能、多模式、高密度集成化逐渐成为了新一代先进系统的发展方向,这也将给小型化与轻量化 T/R 组件带来巨大需求,驱动微波半导体向着高度集成化、模块化方向发展。

(3)新兴民用领域需求快速增长

目前国内红外热成像市场实际年需求与潜在需求存在较大的差异,造成这种差异的主要原因为红外探测器乃至红外热像仪的成本和售价较高。未来,随着红外产品价格下降,性价比提升,未来市场普及率将进一步提升,尤其是对价格更为敏感的民用消费类领域。

国际市场上,新兴经济体的快速发展,红外热像仪成为民用领域的重要消费市场,红外热像仪可以应用于新兴经济体中的安防监控、智慧城市、物联网等领域,需求广阔;在国内市场上,随着我国经济结构调整与经济持续增长,红外热像仪将在工业现代化进程中发挥更大的作用,例如应用于现代化工业生产中的工业检测、AI、检验检疫、消防、机器人等领域。随着产业结构升级及消费水平提高,未来我国民用红外热像仪将更多的应用于汽车辅助驾驶、个人消费电子及物联网等新兴领域,市场规模在不断扩大,需求空间广阔。

微波领域,随着国防信息化建设的持续推进,5G/6G 及卫星通信等基础设施建设的稳步发展,以及汽车等终端应用智能化发展的持续迭代,微波行业需求将有长足的广阔发展空间。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	10,510,118,928.65	8,806,196,667.92	19.35	8,297,070,982.22
归属于上市公司股东的净资产	6,652,169,417.09	5,404,339,027.29	23.09	4,812,320,271.44
营业收入	6,304,144,284.93	4,315,695,760.92	46.07	3,558,596,269.22
利润总额	1,097,741,817.22	428,018,765.34	156.47	399,168,736.99
归属于上市公司股东的净利润	1,124,625,217.01	568,960,574.58	97.66	495,768,536.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,054,415,828.09	510,152,275.78	106.69	436,494,745.12
经营活动产生的现金流量净额	1,855,619,870.15	449,632,715.10	312.70	491,455,477.90
加权平均净资产收益率(%)	18.68	11.31	增加 7.37 个百分点	10.99
基本每股收益(元/股)	2.50	1.28	95.31	1.11
稀释每股收益(元/股)	2.38	1.26	88.89	1.08
研发投入占营业收入的比例(%)	18.30	19.94	减少 1.64 个百分点	19.20

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,136,518,772.01	1,407,274,793.79	1,542,182,460.40	2,218,168,258.73
归属于上市公司股东的净利润	145,818,960.66	205,192,588.62	355,771,228.65	417,842,439.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	132,546,491.55	195,860,334.53	338,210,480.85	387,798,521.16
经营活动产生的现金流量净额	236,023,467.99	82,365,218.06	448,844,465.69	1,088,386,718.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,075
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,097
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
马宏	1,100,000	70,600,000	15.34	0	无		境内自然人
李维诚	-7,563,700	34,906,430	7.58	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	17,509,207	26,958,207	5.86	0	无		境外法人
梁军	-2,951,718	11,533,948	2.51	0	无		境内自然人
方新强	-2,501,985	8,640,000	1.88	0	无		境内自然人
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	641,517	8,367,381	1.82	0	无		境内非国有法人
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	1,911,440	7,857,778	1.71	0	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	6,304,085	7,655,203	1.66	0	无		境内非国有法人
浙江凯新私募基金管理有限公司-杭州产投数兴股权投资合伙企业(有限合伙)	7,563,700	7,563,700	1.64	0	无		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	662,894	5,511,034	1.20	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节“二、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688002　证券简称:睿创微纳　公告编号:2026-025

转债代码:118030　转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 500,000 万元或等值外币
投资种类	仅限投资于信用评级较高、履约能力较强的商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 9 日上午 9 时在公司会议室召开本届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,该议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司使用闲置自有资金进行委托理财时选择的产品品种属于安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用部分闲置自有资金进行委托理财,可以增加资金收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)投资金额

公司使用闲置自有资金进行委托理财,额度合计不超过人民币 500,000 万元或等值外币,上述额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效,可循环滚动使用。期限内任一时点的委托理财金额不超过该议案审议额度。

(三)资金来源

本次公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金,不涉及使用募集资金。

(四)投资方式

本次委托理财仅限投资于信用评级较高、履约能力较强的商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等。同时提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 9 日上午 9 时在公司会议室召开本届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,该议案无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)委托理财风险

尽管公司使用闲置自有资金进行委托理财时选择的产品品种属于安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的投资风险,具体如下:

1、市场风险:包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化,对市场产生一定的影响,导致产品收益的波动,在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响;

2、流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致委托理财资金不能按时变现;

3、信用风险:在进行委托理财资金投资运作过程中,如果所投资的金融产品发行主体发生违约、信用状况恶化、破产等情况,将对产品的收益产生影响,同时委托理财资金管理也受结算风险以及所投资金融产品/资产管理人的管理风险和履约风险的影响;

4、操作风险:如委托理财产品发行人发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件,可能导致收益凭证认购交易失败、资金划拨失败等,从而导致公司的本金及收益发生损失;

5、不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致委托理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

(二)委托理财风险控制措施

1、公司已建立完善的内部控制体系及内控制度,公司制定的《委托理财管理制度》对委托理财交易原则、审批决策流程、业务管理与核算、风险控制与信息披露等方面作出了明确的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

2、公司财务部为委托理财业务的实施和管理部门,负责委托理财产品业务的经办、日常管理和财务核算。公司内审部负责对理财产品进行日常监督,定期或不定期审查理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,对账务处理情况进行核实,并向董事长及董事会审计委员会汇报。公司董事会审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查,对提交董事会审议的委托理财议案进行审核并发表意见。独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请独立的外部审计机构进行委托理财业务的专项审计。

3、公司将严格遵循相关法律法规及公司《委托理财管理制度》的规定进行委托理财事项并按照规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保不影响公司日常经营业务正常开展,保证日常经营资金需求和风险可控的前提下进行的。委托理财有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,不会对公司日常经营造成不利影响。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

证券代码:688002　证券简称:睿创微纳　公告编号:2026-024

转债代码:118030　转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《烟台睿创微纳技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(以下简称“《薪酬管理制度》”)等相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下:

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。

公司董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效,直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、独立董事

公司独立董事实行津贴制,按月发放。独立董事津贴标准为 8,000 元/月(含税),即 9.6 万元/年(含税)

2、非独立董事

公司非独立董事不在公司领取董事津贴。在公司担任高级管理人员职务的非独立董事,按所担任高级管理人员职务领取薪酬。在公司任职未担任高级管理人员职务的非独立董事,按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬按照其在公司担任的具体职务领取薪酬。如高级管理人员在公司兼任其他职位的,该薪酬为其全部职务的薪酬总额。根据高级管理人员实际履职情况,相关薪酬可由公司及/或纳入公司合并报表范围内的子公司承担并支付。

在公司担任高级管理人员职务的非独立董事、在公司任职未担任高级管理人员职务的非独立董事以及公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金、中长期激励收入等构成。其中基本薪酬与公司规模、所在行业、地区的薪酬水平、高级管理人员所承担的责任、风险程度和高管职务贡献等因素挂钩。绩效奖金与当年度集团经营业绩、财务考核指标、绩效指标完成情况挂钩。中长期激励收入按照公司另行实施的激励计划执行。公司确定一定比例的绩效薪酬(2026 年度年终奖)在年度报告披露和